

# 產發署公私(產學)共育國內外高階人才計畫 113 年度第二梯次技術審查入選名單(5 月)

正取班級(6 班)			
領域	編號	開班單位	技術主題
客製化 諮詢	1	社團法人台灣平坦化應用技術協會	生成式 AI-3D IC 封裝技術
	2	國立臺灣科技大學	半導體 AI 技術與應用
技術 研討	3	三建資訊有限公司	CoWos 封裝材料介紹
	4	台灣區電機電子工業同業公會	第三類半導體前沿技術與應用商機研討會
	5	社團法人台灣電子設備協會	扇出形面板級封裝(FOPLP)技術的前景與應用
潛力 學程	6	正修科技大學	先進封裝與測試工程師潛力學程